

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2006年2月9日 (09.02.2006)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2006/013940 A1

(51) 国際特許分類:  
*H04R 19/01* (2006.01)      *H04R 19/04* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/014333

(22) 国際出願日: 2005年8月4日 (04.08.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2004-230407 2004年8月6日 (06.08.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 卷幡勝浩 (MAKIHATA, Katsuhiro). 小倉洋 (OGURA, Hiroshi). 安野功修 (YASUNO, Yoshinobu).

(74) 代理人: 高松猛, 外 (TAKAMATSU, Takeshi et al.); 〒1076013 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーカ森ビル13階 栄光特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

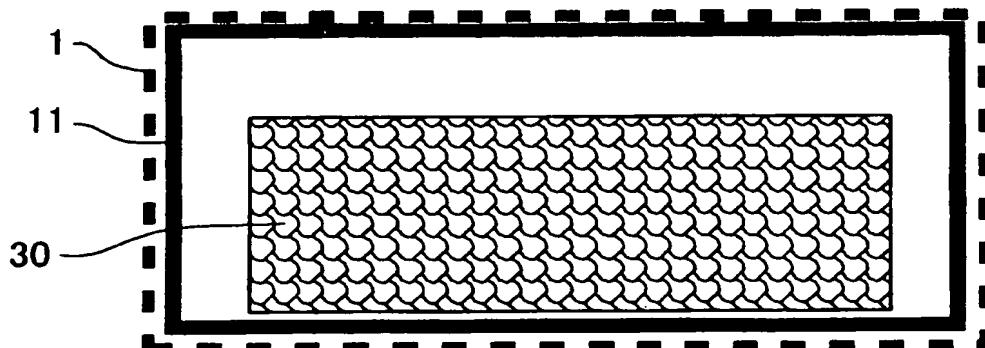
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIGO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

(続葉有)

(54) Title: THERMOSTABLE ELECTRET CONDENSER MICROPHONE

(54) 発明の名称: 耐熱型エレクトレットコンデンサマイクロホン



WO 2006/013940 A1

(57) Abstract: A cage having the whole body of microphone accommodated therein at its external surface has a thermal conductivity lower than those of metals and is covered by a material whose deterioration temperature is higher than the charge vanishing temperature of internal dielectric layer for electret formation, the deterioration temperature being  $\geq 260^{\circ}\text{C}$  to thereby lessen any internal temperature increase by the heat capacity of internal entirety and thermal resistance. In particular, there can be provided a heat resistant structure capable of avoiding any functional deterioration attributed to high heat resulting from brief passage through a reflow solder bath that may be conducted at mounting on application equipment.

(57) 要約: マイクロホン全体を収容している筐体を、筐体外面が熱伝導率が金属よりも低く、かつ材料変質温度が内部のエレクトレット形成用の誘電体層の電荷消失温度よりも高く、かつ材料変質温度が $260^{\circ}\text{C}$ よりも高い材料によって覆うことにより、熱抵抗と内部全体の熱容量によって内部の温度上昇を緩和するもので、特に、適用機器に装着される際、リフローはんだ槽を短時間通過することがあり、そのときの高熱によって機能が損なわれるのを防止することのできる耐熱構造を提供する。



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。